

Express5800/R120h-2M(2nd-Gen) スペック詳細

2020/03/26 版

製品名称			Express5800/R120h-2M									
モデル名			8x.2.5型ドライブモデル		24x.2.5型ドライブモデル		8x3.5型ドライブモデル		12x3.5型ドライブ			
製品型名			N8100-2775Y		N8100-2776Y		N8100-2777Y		N8100-2778Y			
CPU	Processor		インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204(6C/6T, 1.90 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Silver 4208(8C/16T, 2.10 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4210(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Silver 4214(12C/24T, 2.20 GHz, 16.5MB, TDP 85W), Silver 4215(8C/16T, 2.50 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4216(16C/32T, 2.10 GHz, 22MB, TDP 100W), Gold 5215(10C/20T, 2.50 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 5217(8C/16T, 3 GHz, 11MB, TDP 115W), Gold 5218(16C/32T, 2.30 GHz, 22MB, TDP 125W), Gold 5220(18C/36T, 2.20 GHz, 24.75MB, TDP 125W), Gold 5222(4C/8T, 3.80 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 6226(12C/24T, 2.70 GHz, 19.25MB, TDP 125W), Gold 6230(20C/40T, 2.10 GHz, 27.50MB, TDP 125W), Gold 6234(8C/16T, 3.30 GHz, 24.75MB, TDP 130W), Gold 6238(22C/44T, 2.10 GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240(18C/36T, 2.60 GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6242(16C/32T, 2.80 GHz, 22MB, TDP 150W), Gold 6244(8C/16T, 3.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6248(20C/40T, 2.50 GHz, 27.50MB, TDP 150W), Gold 6252(24C/48T, 2.10 GHz, 35.75MB, TDP 150W), Gold 6254(18C/36T, 3.10 GHz, 24.75MB, TDP 200W), Platinum 8260(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8268(24C/48T, 2.90 GHz, 35.75MB, TDP 205W), Platinum 8280(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215M(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238M(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240M(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8260M(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8280M(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215L(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238L(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240L(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8280L(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W)									
		標準搭載数 / 最大搭載数	0/2									
		コントローラ・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)									
		インテル® 64	対応									
		インテル® バーチャライゼーション・テクノロジ	対応									
		インテル® ハイパースレッディング・テクノロジ	対応 (Xeon Bronze 3204は除く)									
		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ	対応 (Xeon Bronze 3204は除く)									
		CPUソケット形状	LGA3647									
		ホットプラグ	-									
		冷却方式	ファンなしヒートシンク									
チップセット			インテル® C621 チップセット									
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	メモリソケット数	標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 1.5TB (24x 64GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) DC Persistent DIMM : 6TB(12x 512GB)									
			増設単位	24								
				1								
				DDR4-2933 Registered DIMM (8/16/32/64GB), DDR4-2933 Load Reduced DIMM (64/128GB) DDRT-2666 DC Persistent DIMM(128/256/512)GB								
				2933MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)								
				23.4GB/s								
				メモリアクセス方式								
				インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)								
				ECC, x4 SDDC								
				対応								
				対応								
				-								
				288 ピン								
				1.2V								
				対応								
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵スロット	フロント	8x2.5型ドライブ		24x2.5型ドライブ		8x3.5型ドライブ		12x3.5型ドライブ		
			リア	8x2.5型増設ドライブ(オプション 最大1個)		2x 2.5型ドライブ(オプション 最大3個), 3x 3.5型ドライブ(オプション 最大1個)		2x M.2 SATAスロット		-		
			内部									
		内蔵標準										
			内蔵最大	2.5型HDD: SATA 48TB (24x 2TB), SAS 57.6TB (24x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 92.16TB (24x 3.84TB), SAS SSD :46.08TB (24x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)		2.5型HDD: SATA 60TB (30x 2TB), SAS 72TB (30x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 115.2TB (30x 3.84TB), SAS SSD :57.6TB (30x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)		3.5型HDD : SATA 180TB(15x 12TB),ニアラインSAS 180TB(15x 12TB) + 2.5型HDD: SATA 8TB (4x 2TB), SAS 9.6TB(4x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 15.36TB(4x 3.84TB), SAS SSD: 7.68TB (4x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)		3.5型HDD : SATA 228TB(19x 12TB),ニアラインSAS 228TB(19x 12TB) + 2.5型HDD: SATA 4TB (2x 2TB), SAS 4.8TB(2x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 7.68TB(2x 3.84TB), SAS SSD: 3.84TB (2x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)		
		ホットスワップ										
		インタフェース規格とRAID構成										
		光ディスクドライブ										
		FDD										
拡張ベイ												
拡張スロット	対応スロット	標準構成 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト, フルレンジス) 1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト, フルレンジス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト, ハーフレンジス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (LOMカード専用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)										
		PCI Express 1.1, 2.0, 3.0										
		マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB										
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200										
		グラフィック表示と 解像度										
標準インタフェース	フロント	1x USB3.0(Type A), 1x USB2.0(Type A) (BMC用), 2xUSB2.0(Type A) (オプション) *12		1x USB3.0(Type A), 1x USB2.0(Type A) (BMC用)		1x USB3.0(Type A), 1x USB2.0(Type A) (BMC用)		-				
		2x USB3.0 (TypeA) , 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 4x データLANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 (RJ-45))										
ネットワーク	内部	1x シリアルポート (オプション) 2x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 3.0										
		オンボード										
		1x Broadcom® BCM5719										
リモートマネージメント	コントローラ	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)										
		対応										
		対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)										
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)	キーボード / マウス	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応										
		BMC										
		Marvell PHY										
BIOS Version (出荷当初)			オプション									
BMC Firmware Revision (出荷当初)			System ROM U30 v2.02 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)									
System Sleep State			1.40 (最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)									
冗長電源			S0, S5									
冗長ファン			対応 (オプション, ホットプラグ可)									
筐体デザイン			対応 (標準, ホットプラグ可)									
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)			2Uラックマウント									
質量 (最小/ 最大)			445.5mm x 679.4mm x 87.3mm (2.5型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず)		445.5mm x 730.2mm x 87.3mm (3.5型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず)		15kg / 39kg		15kg / 45kg			
電源	電源	選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-160) 800W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161, 162) 800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) DC電源ユニット(N8181-163) 800W DC-48V電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) (電源ケーブルは必須選択オプション) *10										
		908VA / 899W (800W電源最大値)										
		1429VA / 1426W *7		1504VA / 1501W *7		1343VA / 1343W *7		1375VA / 1372W *7				
		5134KJ/h		5404KJ/h		4835KJ/h		4940KJ/h				
		対象外		対象外		対象外		対象外				
		34dBa / 34dBA										
		ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床上: 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床上: 0.75m), 環境温度23℃ 動作時: 10～35℃(条件付きで5～40℃/45℃対応可) *11, 保管時: -30～60℃ 動作時: 8～90%, 保管時: 5～95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)										
		VCCI クラス A										
		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware										
		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル										
無償保証内容			3年オンサイト保守サービス(月～金, 9:00～18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)									
インストールOS			3年パーツ保証									
サポートOS	NECサポート	-										
		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard*8, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter*8, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 7.6以降 *5, Red Hat® Enterprise Linux® 8.0 *13 VMware ESXi™ 6.5 Update2以降, VMware ESXi™ 6.7 Update2以降										
動作確認OS *6			最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います									

注意事項

拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで, ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで, MD2 = 167.6mmまで を示します

注釈

- \*1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを全システムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1式は必ず手配してください。
- \*2 必要に応じて手配してください。主な用途については「Flash FDD製品概要と利用ケース」の構成ガイドを参照下さい。
- \*3 VMware ESXi 6.0をインストールした場合、USB2.0で動作します。
- \*4 特定構成(2xCPU(Xeon Silver 4114), 2x16GB DIMM, 1xRAIDコントローラ, 標準ファン, 1x500W電源)での騒音値
- \*5 サポートサービスの提供を受けるにはNECよりLinuxサービスセットの購入が必要です。同一メジャーバージョン内での対応となります。
- \*6 BTOインストール不可。NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux On Express5800」を参照願います。
- \*7 CPU TDPごとの最大電力は8.1.2をご参照ください。
- \*8 本製品はお客様から提供を要求されている場合に限り、お客様へ販売することが認められています。ご購入の際には、事前にお客様より Windows Server 2019のライセンス条項に同意口いていただく必要があります。
- 詳細は<http://jpn.nec.com/windowsserver/2019/down.html> をご覧ください。
- \*10 DC-48V電源のほかDC380V電源を本装置で活用したい方は、弊社営業まで別途お問い合わせください。
- \*11 40℃/45℃環境においてそれぞれ構成制限及び環境制限があります。詳細は「リファレンス」の「40℃/45℃対応についての注意事項」をご参照ください。
- \*12 オプションの「N8154-117 内蔵DVDドライブ増設キット」搭載時